



SENSING  
THE  
BEAUTIFUL LIFE

www.memsic.com

memSic  
美新半导体

### 总部

中国·天津  
天津空港经济区航空路53号

电话: +86-510-66616668  
销售请联系: info@memsic.com

### 美国设计中心

美国·圣何塞  
2570 North First Street, Suite 300, San Jose, CA 95131

电话: +1-408-637-5503  
销售请联系: info@memsic.com

### 无锡研发、运营、制造中心

中国·江苏  
江苏省无锡市新吴区新辉环路2号

电话: +86-510-66616668  
销售请联系: info@memsic.com

### 欧洲设计中心

荷兰·恩斯赫德  
Pantheon 6A - 7521 PR Enschede

销售请联系: info@memsic.com

### 中国绍兴、制造中心

中国·绍兴  
浙江省绍兴市越城区漫池路17号

电话: +86-0575-88660086  
销售请联系: info@memsic.com

### 上海研发、应用开发、销售支持中心

中国·上海  
上海市浦东新区盛夏路666号盛银大厦E座5层505室

电话: 021-62330696  
销售请联系: info@memsic.com

### 深圳应用开发、销售支持中心

中国·深圳  
深圳市宝安区前海卓越时代广场A座1901B

电话: 0755-23306109  
销售请联系: info@memsic.com

### 台湾销售支持中心

中国·台湾  
新竹县竹北市光明六路87-5号702室

电话: +886-3-6214321\*503  
销售请联系: info@memsic.com

扫码关注公众号



## 感知美好生活

美新半导体是全球领先的惯性 MEMS 传感器供应商, 为客户提供从 MEMS 传感芯片、软件算法和应用方案的一站式解决方案。美新半导体大规模稳定量产的产品有全球独有热式加速度计、电容式加速度计、AMR 地磁传感器、低功耗霍尔开关及六轴IMU等产品, 广泛应用于汽车、工业、医疗、可穿戴、智能家居、消费电子等领域, 通过感知物理世界的位移和运动变化, 为人们提供更加智能、可靠、安全的科技体验。

## AMR 3D 地磁传感器

- 超小尺寸
- 低噪声
- 高灵敏度
- 高精度



磁传感器历代产品      手机&平板      车载应用      无人机

<p><b>MMC5603NJ</b> <b>MMC5633NJ</b> <b>MMC5619WA</b> <b>MMC5617WA</b></p>	<p>单片集成的3轴磁传感器 基于先进的AMR技术 晶圆级封装,封装尺寸:0.8×0.8×0.4mm MMC5633NJ&amp;MMC5619WA全面支持I3C接口 MMC5617WA完全本土供应链,AMR在美新绍兴fab制作</p>	
<p><b>MMC3630KJ</b></p>	<p>工艺成熟,性能稳定可靠 低噪声,抗干扰能力强 封装尺寸:1.2×1.2×0.5mm</p>	
<p><b>MMC5983MA</b> <b>MMC3416xPJ</b></p>	<p>温漂低、噪声低、磁滞小、精度高 可靠性高、稳定性好、抗干扰能力强 MMC5983MA 通过AEC-Q100 Grade 2车规级认证 MMC3416xPJ超低功耗、支持多至8个I2C地址</p>	

## 霍尔开关传感器

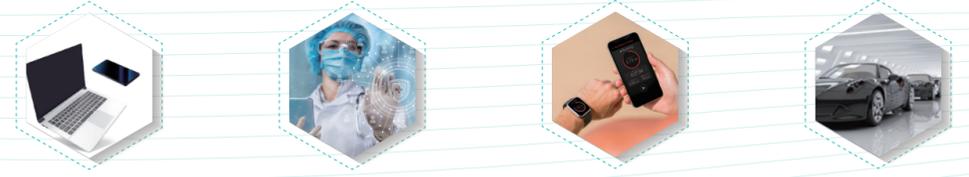
- 超低功耗
- 极小的封装尺寸 丰富的封装类型
- 超宽输入电压范围
- 精准的开关控制



<b>MHA100KN</b>	全极双输出,超低功耗,灵敏度高 封装尺寸:DFN-4 1.0×1.4×0.37mm	
<b>MHA181AS-S</b>	单极输出,超低功耗,灵敏度高 封装尺寸:SOT23-3L 2.9×1.6×1.1mm	
<b>MHA182AS-S</b>	单极输出,超低功耗,灵敏度高 封装尺寸:SOT553 1.6×1.2×0.55mm	
<b>MHA183AS</b>	全极单输出,超低功耗,灵敏度高 封装尺寸:SOT23-3L 2.9×1.6×1.1mm	

## 电容式加速度计及六轴IMU

- 超低功耗
- 极小尺寸
- 丰富的功能及算法支持



<b>MC3416</b>	16位高分辨率,支持I2C通讯方式 低噪声,低零偏,低温漂 封装尺寸:LGA-12 2×2×0.95mm	
<b>MC3419</b> <b>MC3479</b>	16位高分辨率,支持I2C/SPI通讯方式,带FIFO缓存 低噪声,低零偏,低温漂 封装尺寸:LGA-12 2×2×0.95mm	
<b>MC3630</b> <b>MC3632</b> <b>MC3635</b>	14位分辨率,支持I2C/SPI通讯方式,带FIFO缓存 超低功耗,休眠:0.1 μA,嗅探:0.4 μA @6Hz,工作:0.9 μA@25Hz 封装尺寸:LGA-12 2×2×0.95mm MC3635封装尺寸:LGA-10 1.6×1.6×0.94mm	
<b>MCX3500AL</b>	16位分辨率,支持I2C/SPI通讯方式 1.5KB超大FIFO缓存,多种低功耗模式 单/双/三击中断 封装尺寸:LGA-12 2×2×0.73mm	
<b>MIC610xAL</b>	16位高分辨率,3KB 超大FIFO,支持I2C/I3C/SPI通讯方式,最高2200Hz 陀螺仪 ±3dps零漂,±0.05dps/°C温漂,±1%灵敏度误差 封装尺寸:LGA 2.5×3×0.83mm	

## 热式加速度传感器

- 极耐冲击
- 超小尺寸
- 超低温漂



<b>MXC4005XC</b> <b>MXC6655XA</b>	3轴单片集成,晶圆级封装,超小尺寸,性能稳定,良率高 适用手机、平板等消费类电子设备 MXC4005XC封装尺寸:1.2×1.7×0.95mm MXC6655XA封装尺寸:2×2×1mm	
<b>MXR7150VW</b> <b>MXR7999VW</b>	2轴,零偏和灵敏度独立温度补偿,可选平/竖贴封装,安装灵活 模拟输出, MXR7999VW的量程±/ - 2g,灵敏度1000mV/g MXR7150VW的量程±/ - 13.3g,灵敏度150mV/g AEC-Q100 Grade 1车规级认证,广泛适用汽车主动悬挂系统、ESC和EPB系统 封装尺寸:5.5×5.5×2.7mm	
<b>MXD2020EL</b> <b>MXD6235Q</b>	2轴,PWM数字输出 零偏和灵敏度一致性好,易于温度补偿 MXD2020EL量程±/ - 1g,噪声0.2mg/sqrt(Hz) MXD6235Q量程±/ - 1.5g,噪声0.13mg/sqrt(Hz) 适用水平尺,家电以及其它工业类应用 封装尺寸:5.5×5.5×2mm	
<b>MXR7205VW</b>	2轴,零偏和灵敏度独立温度补偿,可选平/竖贴封装,安装灵活 SPI数字输出,量程±/ - 5g,灵敏度800LSB/g AEC-Q100 Grade 2车规级认证,适用汽车ESC和EPB系统 封装尺寸:5.5×5.5×2.7mm	

## 影像稳定驱动芯片

<b>MSD2100WA</b>	10位精度DAC,电流输出±100mA 集成音圈马达智能控制算法 支持1MHz的I2C通信时钟频率,12.5MHz的I3C通信时钟频率,兼容1.2V的IO电压 封装尺寸:0.73 X 1.13 X 0.31mm (6-pin WLCSP)	
<b>MSD4100WA</b>	集成线性霍尔传感器和先进的PID控制算法 集成单通道恒流线性驱动电路,最大输出±170mA 支持I2C通信时钟频率到3.4MHz,I3C通信时钟频率到12.5MHz,兼容1.2V的IO电压 封装尺寸:0.63 X 2.37 X 0.315mm (6-pin WLCSP)	